

СТАТЬИ И МАТЕРИАЛЫ, ОПУБЛИКОВАННЫЕ В ЖУРНАЛЕ "ЭЛЕКТРОНИКА: НАУКА, ТЕХНОЛОГИЯ, БИЗНЕС" В 2015 ГОДУ

ВЫСТАВКИ И КОНФЕРЕНЦИИ

- И.Шахнович, М.Шейкин.** Electronica 2014: приглашение в будущее. Часть 2..... №2, с.24
- И.Шахнович, М.Шейкин.** Electronica 2014: приглашение в будущее. Часть 3..... №3, с.32
- А.Циркунова.** Российская электроника: импортозамещение и перспективы развития..... №4, с.30
- В.Ежов.** "РобоСектор-2015" успешный робототехнический проект в России возможен..... №4, с.114
- М.Гольцова.** ISSCC 2015. Новые микропроцессоры и микроконтроллеры. Еще сложнее и притягательнее..... №5, с.46
- М.Шейкин.** Интернет вещей на практике. Конференция "Встраиваемые технологии 2015"..... №5, с.90
- В.Ежов.** Проблемы обеспечения электромагнитной совместимости радиоэлектронной аппаратуры. По итогам конференции компании "ТЕСТПРИБОР"..... №5, с.156
- П.Куцько.** "Золотой Чип" российской радиоэлектроники..... №7, с.32
- И.Кокорева.** Импортозамещение электронной компонентной базы как элемент модернизации экономики..... №8, с.30

ВЫСТАВКИ И КОНФЕРЕНЦИИ – ПЕЧАТНЫЙ МОНТАЖ

- И.Шахнович.** 3D-инспекция компании Corel: разработка продолжается..... №1, с.198
- К.Кайдалова, М.Лялин, Л.Кастрицкая.** Открытие производственного комплекса монтажа радиоэлектронных компонентов в АУ "ТехноПарк-Мордовия"..... №5, с.168

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА

- С.Лойчиков.** Защищенные ноутбуки GETAC – на службе в армии..... №8 с.118

ИСТОРИЯ ЭЛЕКТРОНИКИ

- Ю.Носов.** О рождении микроэлектроники. Величайшая научно-техническая революция и современность..... №4, с.118
- Полвека АО НИИ "Платан" и завода при НИИ..... №9, с.108

ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ

- В.Хорриг.** Новые источники питания EA Elektro-Automatik. Универсальность без компромиссов..... №4, с.104
- М.Шейкин.** Неочевидные факторы выбора источника питания. Советы специалистов TDK-LAMBDA..... №4, с.108
- Е.Рабинович.** DRF: источники питания премиум-класса на DIN-рейку..... №5, с.112
- М.Шейкин.** Питание для "умного дома". Модульные источники Mornsun LS..... №6, с.106
- О.Сергеев.** Сервоприводы Harmonic Drive: высокоточные и надежные решения для широкого круга задач..... №6, с.112
- А.Федоров.** Профессиональные источники питания DELTA ELEKTRONIKA. Десять преимуществ..... №8, с.122
- А.Федоров.** Источники питания Mean Well – новинки 2015 года..... №9, с.58
- А.Макдессиан, Т.Хайян.** PoE-технология для светодиодного освещения: больше, чем высокая энергоэффективность..... №9, с.66
- М.Шейкин.** Питание светодиодных систем. Решения компании TDK-Lambda..... №9, с.72

М.Нагаи. Высокоэффективные источники питания для российского рынка.....	№10, с.134
В.Горячев, А.Чуприн. Источник вторичного электропитания для специальной бортовой аппаратуры. Формирование внутреннего напряжения питания.....	№10, с.138

КОМПЕТЕНТНОЕ МНЕНИЕ

Ю.Борисов. Емкий государственный оборонный заказ – это шанс для промышленности.....	№1, с.10
Н.Нишизава. Мы говорим конкурентам Goodbye: Yamaha включает новую скорость.....	№2, с.8
А.Брыкин. Для нас кадры – это стратегия.....	№3, с.10
Ж.Фрескэ. Мы любим трудные вызовы.....	№4, с.12
В.Картавцев. Для технологического импортозамещения радиоэлектронной промышленности необходима система межотраслевой координации.....	№4, с.18
А.А.Кучин. Мы не вправе работать плохо.....	№5, с.10
В.Шлак, И.Корнеев. Хочешь чего-то добиться – желай невозможного.....	№6, с.10
А.Роуз. Цель Fujitsu – общество, основанное на знаниях.....	№6, с.22
О.Бочкарев. Мы решаем задачу технологической независимости.....	№7, с.10
М.Павлюк. Нам дали шанс, который выпадает раз в жизни.....	№7, с.18
И.Анцев. Мы займем серьезный сегмент гражданского рынка.....	№8, с.10
С.Власов. Мы открыты для любого диалога.....	№9, с.12
Филлип Лопрести. Магниторезистивная память – технология, бизнес, перспективы.....	№10, с.12
А.Циркунова, И.Шахнович. Государственный оборонный заказ: по новым правилам.....	№10, с.50
А.Паньков. Новые машины обязывают приобретать новые знания.....	№10, с.60
В.Фридлянд. Жить в этом мире и не влиять на его изменения – не интересно.....	№10, с.70

КОМПЬЮТЕРНАЯ И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА

Ю.Широков. Защищенные компьютеры: стандарты и технологии.....	№1, с.120
М.Шейкин. Прошлое и настоящее российских суперкомпьютеров. По материалам докладов третьего национального суперкомпьютерного форума. Часть 1.....	№1, с.132
М.Шейкин. Прошлое и настоящее российских суперкомпьютеров. По материалам докладов третьего национального суперкомпьютерного форума. Часть 2.....	№3, с.114

КОНТРОЛЬ И ИЗМЕРЕНИЯ – ПЕЧАТНЫЙ МОНТАЖ

Э.Сахно, И.Дорощенко. Испытания печатных плат электронной аппаратуры по гармонизированным стандартам.....	№2, с.224
А.Иванов. Внутрисхемный тестер со встроенной системой периферийного сканирования: особенности построения.....	№8, с.166

МИКРОПРОЦЕССОРЫ И МИКРОКОНТРОЛЛЕРЫ

Р.Судхакар. MIPS – это прекрасная архитектура.....	№5, с.62
А.Эйлэнд. Выбор микроконтроллера: 8- или 32-разрядный?.....	№5, с.74
П.Пастухов, П.Леонов. Быстродействующие ОЗУ – проблемы создания.....	№5, с.80
М.Гольцова. Рынок Микроконтроллеров. Конкурентная борьба усиливается.....	№7, с.64

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

И.Шахнович. 3D-MID – это новые возможности.....	№1, с.98
В.Плебанович. Создание ЭКБ. Инновационные решения или импортозамещение?.....	№1, с.110
М.Голубьев. Герметизация кабельных разъемов: как обеспечить надежную защиту.....	№3, с.124
И.Шахнович. 3D-принтеры компании voxeljet: как стартап становится бизнесом.....	№3, с.128
С.Кузьмин, В.Матвеев. Технология наноструктурирования материалов синхротронным излучением.....	№4, с.38
Н.Василенков, А.Максимов, С.Грабчиков, С.Ластовский. Специализированные радиационно-защитные корпуса для изделий микроэлектроники.....	№4, с.50
В.Плебанович. Двухсторонняя литография – решение проблемы отвода тепла и разводки межсоединений в ИМС.....	№4, с.58
А.Балакирев, А.Туркин. Перспективы нитрида галлия в СВЧ- электронике. Решения компании RFHIC.....	№4, с.64
А.Алексеев. Разработка отечественного высокотехнологичного оборудования – важный шаг на пути к полноценному импортозамещению ЭКБ.....	№4, с.70
А.Брыкин, А.Артемов, Д.Арсеньева. Электроконденсационный метод синтеза кремния, углерода и карбида кремния.....	№4, с.74
Е.Ермолаев, П.Козлов, В.Егошин, Д.Дмитриев. Металлокерамические платы и корпуса микросхем повышенной степени интеграции. Обеспечение вакуумплотности.....	№5, с.116
В.Плебанович. Безмасковая литография – требование сегодняшнего дня.....	№7, с.112
Е.Ермолаев, П.Козлов, В.Егошин. Обеспечение надежного соединения металлизационного покрытия с керамикой в условиях массового производства МКК для ИС.....	№7, с.120
А.Хохлун. Концепция создания в России мини-фабрик по производству современных интегральных микросхем.....	№9, с.88
А.Наумов. Рынок поликристаллического кремния: состояние и перспективы.....	№9, с.94
С.Потапов. Композитные теплопроводящие материалы для изделий электроники.....	№9, с.102

ОБОРУДОВАНИЕ – ПЕЧАТНЫЙ МОНТАЖ

Д.Иванов. Новое поколение принтеров струйной печати.....	№1, с.176
А.Калмыков, В.Мейлицев. Платформа Fusion: функциональность, производительность, качество.....	№3, с.180
Е.Мордкович. Лидер развивает успех: новое поколение "летающих" пробников от компании SPEA.....	№3, с.188
А.Калмыков, В.Мейлицев. Платформа Fusion: функциональность, производительность, качество.....	№4, с.186
И.Рыков, О.Суворов. Решение для кабельного производства: тестер проводного монтажа W434R.....	№6, с.153
Д.Гарбуз, Ю.Сварковская. Системы отмывки SYSTRONIC – комплексное решение для качественной отмывки печатных плат и узлов.....	№8, с.162

ПОРТРЕТ ФИРМЫ – ПЕЧАТНЫЙ МОНТАЖ

ООО "СОВТЕСТАТ".....	№7, с.164
----------------------	-----------

ПЕЧАТНЫЙ МОНТАЖ

Р.Кондратюк. Припой 80Au20Sn – свойства и особенности применения №10, с.154

ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ – ПЕЧАТНЫЙ МОНТАЖ

С.Федоров. Развитие компании в нынешних условиях – опыт и реалии: на что делать ставку №2, с.220

Г.Менгден. Использование установки парофазной пайки Condenso X. Опыт компании "ПАНТЕС" №4, с.168

В.Ефанов. FIREFLY – решение для автоматизации монтажа отечественных планарных микросхем №4, с.174

ПРОЕКТИРОВАНИЕ – ПЕЧАТНЫЙ МОНТАЖ

Л.Прудникова, В.Мейлицев. Проектирование электронных модулей: общие принципы и распространенные ошибки №6, с.184

РЕПОРТАЖ С ПРОИЗВОДСТВА

И.Шахнович, М.Шейкин. Жидкокристаллические индикаторы: сделано в России. Визит на производство ООО "МЭЛТ" №2, с.68

В.Мейлицев, И.Шахнович. Система Zeta компании Kothak как новая философия производства электротехнических изделий. Визит на завод "Грундфос Истра" №10, с.80

РЕПОРТАЖ С ПРОИЗВОДСТВА – ПЕЧАТНЫЙ МОНТАЖ

И.Шахнович. Когда готовность встречается с возможностью. Визит в ОАО НТЦ "Завод "Ленинец" №1, с.178

И.Шахнович. Российский интеллект и немецкий порядок. Визит на производство группы компаний "ДИАЛ" №2, с.185

В.Мейлицев. Комплексный подход решает всё. Визит на новую линию поверхностного монтажа компании "ПСБ Технологии" №2, с.200

И.Шахнович. Технологические песни Ямато. Визит на производство компании Yamaha Motor (М) №3, с.161

И.Шахнович. Швейцарское качество без тайн. Визит в компанию Essemtec №4, с.153

И.Шахнович. Автоматизация – путь к успеху. Визит в компанию "Глазов. Электрон" №7, с.145

В.Мейлицев, И.Шахнович. Дорога в будущее начинается с первого шага. Визит на Донской завод радиодеталей №8, с.139

РЫНОК – ПЕЧАТНЫЙ МОНТАЖ

В.Лысов. Аутсорсинг в производстве электроники ответственного применения: "Россия VS" №2, с.214

РЫНОК ДИСТРИБУЦИИ

Н.Дмитриев. RS Components: уникальные предложения от уникальной компании №2, с.62

Й.Доминиак, Т.Айхорст. Triquint + RFMD = Qorvo: объединиться, чтобы победить №6, с.46

СВЕТОДИОДНАЯ СВЕТОТЕХНИКА

А.Циркунова. Как это работает? Конструкторское бюро передовой инженерии "КБ-71" №8, с.66

СВЧ-ЭЛЕКТРОНИКА

С.Гармаш, А.Кишинский, Е.Маркинов, А.Радченко, Д.Суханов. Современные твердотельные свч-модули. Новые разработки компании "Микроволновые системы" №6, с.82

В.Немудров, М.Бычков, Л.Ионов, И.Малышев, И.Мухин, В.Репин, Р.Шабардин. СВЧ кремний-германиевые монолитные интегральные схемы: преимущества и достижения №6, с.92

И.Иванов, Н.Скрипкин, К.Ходатаев, С.Боев, А.Вагин. Экспериментальное исследование самосинхронизации магнетронов 3-миллиметрового диапазона №6, с.98

Н.Скрипкин, П.Чумерин, Ю.Юшков, В.Ваулин, В.Слинко, А.Пересыпкин. Генераторный СВЧ-модуль на основе магнетрона х-диапазона и резонансного СВЧ-компрессора №7, с.88

П.Мальцев, И.Шахнович. СВЧ-технологии – основа электроники будущего. Тенденции и рынки №8, с.72

А.Устинов, В.Кочемасов, Е.Хасьянова. Ферритовые материалы для устройств СВЧ-электроники. Основные критерии выбора №8, с.86

М.Ефремова, И.Иванов, Н.Скрипкин. Волноводные и квазиоптические способы суммирования мощности генераторов трехмиллиметрового диапазона длин волн №8, с.94

СВЯЗЬ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ

З.М.Редл. Доступные инновации от MediaTek: каждый может быть по-своему гением №5, с.104

И.Шахнович. Системы беспроводной связи 5G: телекоммуникационная парадигма, которая изменит мир. Краткие тезисы №7, с.48

Т.Сайзер. Наша задача – разработка технологий будущего №7, с.56

С.Попов. Конференция в российском центре науки о телевидении №9, с.84

С.Попов, О.Саликова. Cisco Connect – 2015 и тут импортзамещение №10, с.150

СИСТЕМЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Д.Радченко. Современные САПР Synopsys – новые возможности для традиционных технологий №4, с.80

И.Пушница, О.Токмаков, Д.Красовицкий, О.Фазылханов, А.Филаретов, В.Чальский. Проектирование СВЧ МИС. Статический учет естественной изменчивости технологических процессов №4, с.88

Д.Фролов, А.Круглов, К.Мещерякова. ANSYS: пять составляющих комплексного моделирования электроники №6, с.118

А.Сергеев. Групповая разработка проектов в OrCAD Engineering Data Management №6, с.122

Т.Халфхилл. Новейшие процессоры Synopsys для встраиваемых приложений – более высокая производительность и гибкость №7, с.94

А.Сергеев. OrCAD 2015 – новые приложения №7, с.104

Т.Халфхилл. Новейшие процессорные ядра Synopsys для встраиваемых приложений – более высокая производительность и гибкость. Часть 2 №8, с.104

К.Мещерякова. Тепловой режим работы мощных светодиодов – моделирование в ANSYS ICEPAK №8, с.114

А.Сергеев. OrCAD Component Information Portal: инструмент управления базой данных электронных компонентов №9, с.76

Е.Николаев. Итоги 12-й конференции пользователей ANSYS/CAE/FEM: секция "Электромагнитный анализ и радиоэлектроника" №9, с.82

П.Тихомиров, П.Пфеффли, Р.Боргес. Моделирование деградации и обратимых отказов полупроводниковых приборов с использованием TCAD Sentaurus..... №10, с.142

СИСТЕМЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ – ПЕЧАТНЫЙ МОНТАЖ

В.Мейлицев. САПР печатных плат Cadence Allegro – новые возможности. Семинар компаний "ПСБ СОФТ" и "ПСБ технологии" .. №1, с.161

А.Сергеев. OrCAD Capture/PSpice версии 16.67 – новые возможности для разработчика №1, с.192

А.Сарафанов, В.Воловиков. Применение параметризованных моделей и макромоделей тепловых процессов конструкций РЭА. в рамках программного комплекса ТРИАНА №7, с.180

СОБЫТИЕ НОМЕРА

И.Шахнович. Electronica 2014. Приглашение в будущее №1, с.20

М.Гольцова. Международной конференции IEDM 60 лет. Кремниевая технология достигла предела или у нее есть будущее?..... №2, с.48

М.Гольцова. ISSCC 2015. Жизнь за пределами 10 нм..... №3, с.54

С.Хохлов. Итоги деятельности радиоэлектронной промышленности в 2014 году. Основные задачи и направления развития на 2015 год..... №5, с.20

С.Петрова. Расширенное совещание руководителей предприятий радиоэлектронной промышленности №5, с.30

М.Шейкин. Имя нам – интернет вещей. Обзор выставки Embedded World – 2015. Часть 1..... №6, с.34

М.Шейкин. Имя нам – интернет вещей. Обзор выставки Embedded World – 2015. Часть 2 №7, с.38

И.Шахнович. Российская радиоэлектроника. новые вызовы и перспективы. Итоги XIV отраслевой научно-технической конференции №9, с.22

И.Шахнович. Симфония микроэлектроники: главное – не останавливаться. Итоги международной конференции "Микроэлектроника-2015" ("Интегральные схемы и микроэлектронные модули – проектирование, производство и применение")..... №10, с.30

СРЕДСТВА ОТОБРАЖЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ

В.Беляев. Международная конференция по жидким кристаллам. Экзотика и реальность №1, с.90

В.Беляев. Жидкокристаллические дисплеи. Технологии настоящего и будущего. Часть 1. От пикселя до гибкой подложки .. №8, с.36

И.Матешев, А.Туркин. Sharp и aU OptiOnicS диктуют правила игры на мировом рынке ЖК-дисплеев №8, с.48

А.Павленко. OLED-технологии – современные достижения №8, с.58

В.Беляев. Жидкокристаллические дисплеи. Технологии настоящего и будущего. Часть 2. Новые технологии и области применения ЖК-дисплеев №10, с.124

ТЕМА ГОДА: КОНТРОЛЬ И ИЗМЕРЕНИЯ

И.Шахнович. Как совместить несовместимое? Визит в компанию Rohde & Schwarz Messgeratbau №1, с.145

Ю.Штайгмюллер. Rohde & Schwarz. философия качества..... №1, с.149

Ф.Герхардес. Векторные анализаторы ShockLine – компактные, недорогие, функциональные №1, с.156

Ей Ху Син. Ручные приборы Keysight: новинки и тенденции. №2, с.173

А.Подольский. Векторный анализатор сигналов PXIE-5668R: преимущества и области применения №2, с.180

Д.Тручард. Мы всегда думаем о будущем №3, с.141

С.Никولين, А.Торгованов. Проектирование усилителей СВЧ-мощности. Эффективность метода удаленной переменной нагрузки №3, с.148

Ж.-Ф.Пиел. Спектроскопическая рефлектометрия – эффективный метод исследования многослойных структур №3, с.154

Р.Николс. Мы уже сегодня можем предложить комплексные решения для сетей будущего – 5G..... №4, с.129

Tektronix представляет новую продукцию №4, с.136

А.Ляпин. Визуализация тонких структур – современные технологии. Часть 1 №4, с.140

И.Шахнович. Компания Остек открывает Центр технологий контроля..... №4, с.148

Д.Чи. Опередивший технологии. Новые осциллографы Keysight Infiniium V №5, с.127

В.Плебанович. Автоматический контроль микродефектности на полупроводниковых пластинах..... №5, с.132

А.Ляпин. Визуализация тонких структур – современные технологии. Часть 2 №5, с.142

Д.Боррилл. Новая архитектура векторных анализаторов цепей: как повысить эффективность измерений №6, с.125

А.Бегишев. Осциллографы InfiniVision 3000T компании Keysight – прикоснись, проникни в суть, найди решение №6, с.130

Н.Егоров, В.Кочемасов. Генераторы сигналов для тестирования РЛС – продукция компании АWT №6, с.142

А.Ляпин. Визуализация тонких структур – современные технологии. Часть 3 №6, с.146

Н.Гомьеро. Объединиться, чтобы быть на шаг впереди..... №7, с.131

Д.Жуге, О.Туркалов. Динамический диапазон – понятие расплывчатое? №7, с.136

А.Штефан. Тестирование технологии LTE-Advanced – решение компании Rohde & Schwarz №7, с.140

А.Зуйков. Автоматизация работы метрологической службы – программное обеспечение Fluke MET/CAL..... №8, с.127

Зондовые станции компании SUPER SOLUTIONS & SERVICES №8, с.135

Г.Бобов. Цель – не продать, а решить задачу..... №9, с.119

Л.Белов, И.Сокальский. Анализаторы пассивной интермодуляции – продукция компании АWT GLOBAL №9, с.128

Д.Величко. Современные материалы для защиты от воздействия магнитных полей промышленной частоты №9, с.132

А.Кривов, А.Небогин. Автоматизированные системы тестирования приемо-передающих модулей – решения компании "Радиолан" №9, с.142

Ж.-П.Гильме. Измерение параметров усилителя мощности в импульсных режимах: использование BA1 Anritsu VectorStar №10, с.161

А.Бардаков. Автоматизированная фокусировка в тепловизорах – решения компании Fluke №10, с.166

Новинки компании Keysight Technologies. №2, с.178; №3, с.158; №4, с.138; №5, с.152; №6, с.140; №8, с.136; №9, с.138

ТЕХНОЛОГИИ – ПЕЧАТНЫЙ МОНТАЖ

Л.Бойкова. Инспекция – на высоте. Выявление приподнятых компонентов и выводов путем измерений по оси Z в трехмерной системе автоматической оптической инспекции.....	№2, с.230
Н.Разумнева. Прямая печать проводящих материалов. Часть I.....	№3, с.192
Н.Разумнева. Прямая печать проводящих материалов. Часть II.....	№4, с.178
Е.Борисов, С.Чигиринский, В.Мейлицев. Групповая пайка. Технология компании SST.....	№5, с.172
Н.Разумнева. Постановка прикладных исследований технологий печатной электроники: выбор струйного принтера.....	№6, с.166
В.Рябушкин. Что надо знать разработчику печатных плат: выбор базового материала.....	№6, с.176
С.Чигиринский, В.Мейлицев. Методы контроля материалов низкотемпературной керамики. Технологии компании Ferro.....	№7, с.166
В.Рябушкин. Что надо знать разработчику печатных плат: металлизация и финишные покрытия.....	№7, с.174
В.Рябушкин. Что надо знать разработчику печатных плат: согласование параметров платы в процессе производства.....	№8, с.172
А.Кантер. Внедрение технологии вакуумной пайки. Повышение качества выпускаемой продукции.....	№8, с.176

УМНЫЙ ДОМ

В.Беляев, К.Нессемон, В.Корольков, Д.Суарес. "Умный дом".....	№2, с.152
--	-----------

УПРАВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВОМ

Д.Васильев. Качество по требованию с помощью MES-системы "СМАРТ".....	№2, с.166
Д.Кулицкий. Как повысить эффективность управления производством с помощью MES-системы СМАРТ.....	№7, с.126

УПРАВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВОМ – ПЕЧАТНЫЙ МОНТАЖ

Е.Марченко. Контроль в реальном времени.....	№5, с.159
---	-----------

ЭКОНОМИКА + БИЗНЕС

И.Корнеев. Как поддержать отечественных разработчиков производителей чипов и РЭА на открытом рынке?.....	№5, с.122
---	-----------

ЭЛЕМЕНТНАЯ БАЗА ЭЛЕКТРОНИКИ

М.Шейкин. АЦП на голодной диете. Как снизить энергопотребление входных каскадов приборов сбора данных.....	№1, с.52
В.Майская. Системы памяти следующих поколений. Разрушение "стены памяти". Часть 2.....	№1, с.58
И.Ли, С.Калушин. Катодные узлы импульсных магнетронов - особенности конструирования.....	№4, с.72
С.Дингес, В.Кочемасов. Генераторы с цифровой настройкой – возможности и области применения.....	№1, с.80
А.Новожилов, А.Сафонов. Микрофлюидные бумажные сенсоры – "Лаборатория на чипе".....	№2, с.80
Ю.Мякочин, М.Кузнецов, В.Любицин. Как наладить разработку отечественной радиоэлектроники? Подход компании "Миландр".....	№2, с.92
А.Багдасарян, С.Багдасарян. Датчики для системы мониторинга искусственных сооружений.....	№2, с.96

А.Голощاپов. Энкодеры и датчики Zettlex на основе новой технологии индуктивных измерений.....	№2, с.106
Ю.Пономарёв. Выбор виброакселерометров: простое решение сложной задачи.....	№2, с.116
В.Капустин, И.Ли. Скандатные катоды СВЧ-приборов: достижения и перспективы.....	№2, с.124
А.Константинов. Надежные средства измерения и системы контроля под маркой PEPPERL-FUCHS FA.....	№2, с.138
И.Викүлов. СВЧ-электроника сегодня: Направления и вызовы. №3, с.64	
Н.Скрипкин, П.Чумерин, Ю.Юшков. Перспективы создания генераторных СВЧ-модулей на основе безнакальных магнетронов и резонансных СВЧ-компрессоров... №3, с.74	
Л.Белов, В.Кочемасов, Е.Строганова. Пассивная интермодуляция в СВЧ-цепях. механизмы появления, методы измерения и способы снижения.....	№3, с.80
М.Белкин, В.Яковлев. Викселоника – новое направление оптоэлектронной обработки радиосигналов. Часть 1. Компонентная база.....	№3, с.92
А.Багдасарян, В.Днепровский, Г.Карапетьян, С.Нефедов, О.Зорин. Акустоэлектронные радиокомпоненты для неразрушающего контроля.....	№4, с.96
И.Иванов, Н.Петюшин, Н.Скрипкин. Сумматор мощности магнетронов 3-миллиметрового диапазона длин волн.....	№5, с.92
А.Итальянцев, Ю.Шульга, Д.Чашин, О.Шарпинский. Современные изделия пьезоэлектроники: новые возможности. №5, с.96	
М.Гольцова. Специализированные конденсаторы, резисторы и индуктивности. Блестящее будущее миниатюрных прецизионных компонентов.....	№6, с.52
К.Джуринский, В.Батаев, С.Легенкин, М.Левашов. Соединители SMP. Основные типы, параметры и применение... №6, с.66	
В.Любицин. Высокоскоростной многокластерный интегрированный модуль обработки данных.....	№6, с.78
И.Туркин. Квазиверные фильтры на ПАВ: частоты, полторы пропускания, коррекция АЧХ.....	№7, с.72
В.Шубарев, И.Лазер, Ю.Ивачев, Е.Соболев. Инновационные разработки ОАО "Авангард" для водоканалов России.....	№7, с.78
Ю.Завалин, В.Немудров, А.Гришаков, Д.Куликов. Полукажанные СМК – основа мелкосерийного производства СБИС специального назначения.....	№9, с.42
П.Машевич, В.Мартыненко, Т.Крицкая, В.Мускатинов, А.Бормотов, М.Тогаев. Современные СВТ-модули на напряжениях 1200–1700 В для энергосберегающих электроприводов.....	№9, с.50
И.Романова. Компания AMIC Technology на российском рынке. Новая продукция.....	№10, с.94
А.Барон, Л.Бабушкина. Особенности устройств хранения данных для промышленных применений.....	№10, с.102
В.Кочемасов, Е.Хасьянова. Кварцевые резонаторы - особенности и области применения.....	№10, с.106
П.Мальцев. Полупроводниковая СВЧ-электроника в России. И институт СВЧЭТ РАН – исследования и разработка.....	№10, с.1114